

저스텍
(417840)

김아영

ahyoung.kim@daishin.com

투자 의견

N/R

6개월 목표주가

N/R

현재주가

(26.02.20)

6,600

스몰캡업종

2026년 신제품 수주 확대
와 이익 레버리지 본격화

- 글로벌 IDM 중심으로 습도, AMC 제어하는 반도체 수율 개선 업체
- 2세대 JFS 확산과 3세대 고ASP 제품 진입으로 체급 상승 구간 진입
- 2026년 수주 확대, ASP 상승효과로 영업이익 레버리지 본격화 전망

글로벌 IDM 중심의 반도체 수율 개선 '습도, AMC 제어' 솔루션 업체

저스텍은 반도체 제조공정 중 FOUP, EFEM 구간의 습도 및 분자오염(AMC)을 제어해 수율을 개선하는 N₂ Purge 기반 환경제어 시스템 전문 업체. 3Q25 누계기준 매출 비중은 반도체 83%, 디스플레이 7%, 태양광 8%, 2차전지 1%. 주요고객은 글로벌 IDM 업체로 상위 3개 고객사가 매출의 79%를 차지함. 핵심 제품군은 LPM, CFB, JFS이며 최근에는 HBM용 Hybrid Bonder 개발 등 첨단 패키징 장비로 포트폴리오를 확장 중

JFS 증설 사이클 본격화와 3세대 고ASP 제품으로 체급 변화

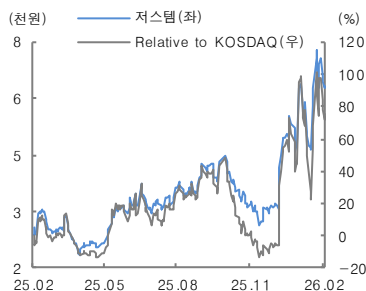
- 1) 2세대 JFS 증설이 실적을 견인: JFS는 기존 N₂ Purge 대비 제어 범위와 안정성이 확장된 장비로 신규 Fab 및 HBM 라인 증설 시 채택 가능
- 2) 3세대 신제품 진입 시 ASP 상승과 이익 레버리지 확대 가능성: EFEM 내부 환경을 통합 제어하는 고사양 모델로 단가가 수배까지 상승. 기존 FOUP 제어→EFEM 영역 확장→공정 전 구간 환경 안정화로 구조적으로 성장 국면
- 3) 디스플레이, 플라스마 사업 확대에 따른 포트폴리오 다변화: OLED 공정에서의 이오나이저 수요 증가, 중화권의 장비 투자 회복이 맞물리며 외형 확대

2026년 증설 사이클 수혜에 따른 실적 레버리지 본격화

2026년 매출액은 807억원(YoY +61.6%), 영업이익은 197억원(+239.2%)을 전망. 매출 증가는 1) HBM 및 선단공정 증설에 따른 2세대 JFS 물량의 본격 증가 2) 3세대 고사양 제품의 수주 가시화에 따른 ASP 상승효과에 기인. 2026년은 고정비 부담을 상쇄하는 구간으로 영업 레버리지가 크게 상승 가능. 현재 주가는 2026년 예상 당기순이익의 PER 8배 수준으로 중소형 반도체 장비 평균 대비 프리미엄을 정당화할 수 있는 구간에 진입 가능성 높음

KOSDAQ	1154
시가총액	1,490억원
시가총액비중	0.03%
자본금(보통주)	36억원
52주 최고/최저	7,500원 / 2,197원
120일 평균거래대금	49억원
외국인지분율	2.37%
주요주주	임영진 외 3인 28.69%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-0.8	83.1	59.3	130.5
상대수익률	-14.9	52.0	17.3	56.1



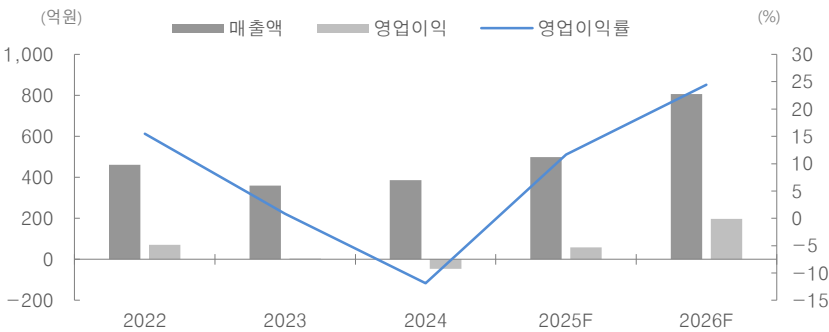
영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F
매출액	461	359	387	499	807
영업이익	71	3	-46	58	197
세전순이익	74	-48	-32	74	197
총당기순이익	63	-34	-22	59	158
지배지분순이익	63	-34	-21	59	158
EPS	1,171	-486	-302	813	2,174
PER	6.4	NA	NA	8.1	3.0
BPS	3,130	2,307	2,255	12,030	14,204
PBR	2.1	2.8	2.9	0.5	0.5
ROE	24.9	-6.8	-4.4	6.8	15.3

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 저스텍, 대신증권 Research Center

그림 1. 저스템 매출액 및 영업이익 추이



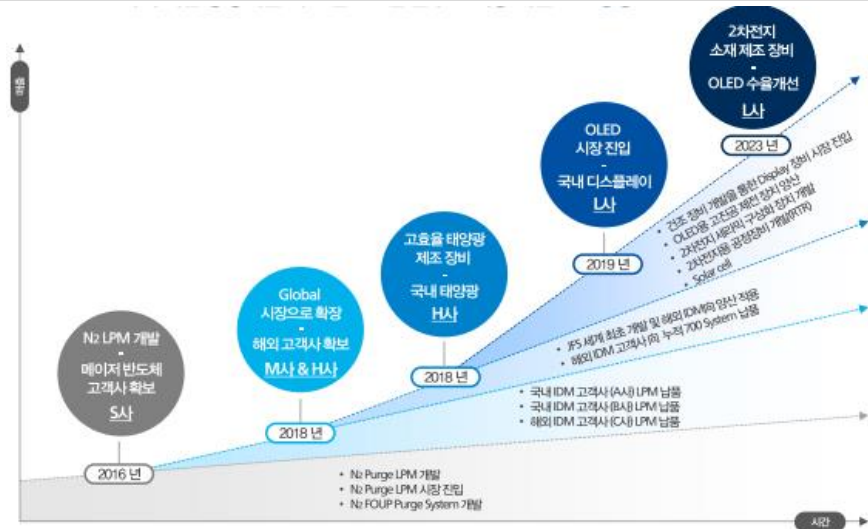
자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

표 1. 저스템 분기 및 연도별 실적 추이 (단위: 억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25F	2023	2024	2025F	2026F
매출액	106	113	121	159	359	387	499	807
yoy (%)	162.4	46.9	-24.6	45.9	-22.1	7.7	29.0	61.6
반도체	79	98	106	130	222	234	412	565
디스플레이	10	3	11	15	93	59	40	121
태양광	15	12	0	10	24	88	36	58
2차전지	2	0	2	2	14	5	7	20
기타	0	0	2	2	6	1	4	10
영업이익	17	21	5	25	3	-46	58	197
yoy(%)	흑자전환	흑자전환	-48.9	398.5	-95.7	적자전환	흑자전환	239.2
영업이익률 (%)	15.6	18.2	4.5	15.7	0.9	-11.9	11.7	24.5
당기순이익	15	16	8	20	-34	-22	59	158
yoy(%)	흑자전환	흑자전환	77.2	-35.5	적자전환	적자지속	흑자전환	167.5
당기순이익률 (%)	14.5	14.3	6.3	12.6	-9.4	-5.6	11.8	19.6

자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

그림 2. 저스템의 원천기술 기반 성장스토리



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

글로벌 IDM 중심의 반도체 수율개선 ‘습도, AMC 제어’ 솔루션 업체

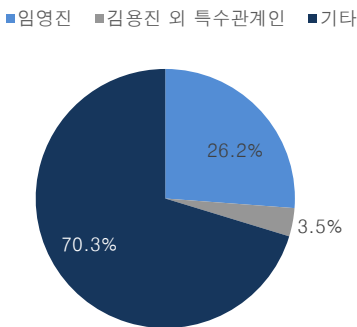
반도체 EFEM, FOUP
환경 제어 기술을 국
산화한 수율개선 전문
업체

저스팀은 2016년 설립된 반도체 공정 환경제어 전문 기업으로 FOUP, EFEM 구간의 습도와 분자오염(AMC)을 제어해 반도체 수율을 개선하는 N₂ Purge 기반 솔루션을 공급함. 창립 초기부터 반도체, 디스플레이 장비 경력 중심 인력으로 구성됐으며, 대표이사를 포함한 경영진도 현장 경험 기반의 기술 중심 경영을 이어가고 있음. 매출의 약 10% 이상을 R&D에 투자하고, 연구 인력이 전체의 30%를 차지하는 등 기술 기반 회사의 성격이 뚜렷. 외산 제품 중심이던 Load Port 시장에서 약 110종 이상의 Stage를 자체 개발하며, 기술 국산화에 성공했고 이를 기반으로 글로벌 IDM 고객사에 안정적으로 공급 중

2세대 JFS 확산으로
선단공정 증설 수혜
본격화

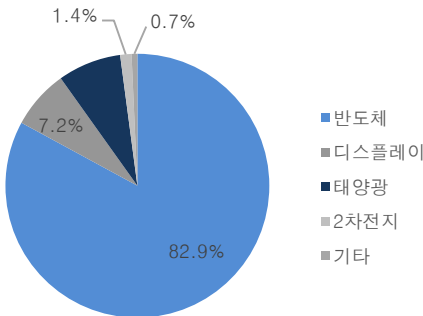
동사는 매엽식 장비용 LPM, 배치식 장비용 BIP, Etch 전후 오염 제거용 CFB, EFEM 기류 제어 기반 2세대 JFS까지 제품 라인업을 확장했으며, JFS를 통해 EFEM 내부 45% 습도를 FOUP 내부 1%까지 제어하는 기술을 상용화함. 3Q25 누계기준 사업부문 별 매출 비중은 반도체 83%, 디스플레이 7%, 태양광 8%, 2차전지 1%. 주요 고객은 글로벌 IDM 업체로 3Q25 기준 상위 3개 고객 매출 비중이 79%를 차지함 (B사 47%, C사 21%, A사 11%) 전방시장 CAPA 증설과 EFEM 환경 제어 영역의 표준화 수혜를 받는 구조로 선단공정 확대 국면에서 실적 가시성이 높아지는 산업적 위치를 확보

그림 3. 저스팀 주주구성



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

그림 4. 저스팀 사업부문별 매출 비중(3Q25 누계)



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

그림 5. 저스팀의 주요 사업 영역



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

AI, HBM 증설 수혜, 점유율 85% 기반의 구조적 성장 스토리

1. 공정 트렌드: AI, HBM, 선단 미세화로 'EFEM 구간' 환경 제어가 수율의 병목으로 부상

저스팀이 포지셔닝한 FOUP, EFEM 구간은 공정 난이도가 올라갈수록 중요도가 커짐. HBM/선단 공정 확대는 공정 민감도를 높여 **습도, AMC(분자오염), 파티클 관리가 곧 수율/원가로 직결**. JFS가 EFEM 내부 기류를 제어해 FOUP 내부 습도를 1% 수준까지 낮추는 접근을 상용화함. 2026년 1월 삼성전자향으로 초기 50대 시스템 공급 후 한 달 만에 310대 추가 수주가 발생하며, 파일럿 적용 이후 라인 확산이 빠르게 진행되는 흐름을 확인할 수 있음

2. 왜 '85% 점유율'이 가능한가: 표준화+검증+납기/셋업 역량

점유율은 '제품 성능'만으로 유지되지 않고, 실제 **팹 운영 환경에서의 적용 속도, 기존 장비와의 호환성, 검증 데이터 축적이 결합될 때 표준화가 이루어짐**. 저스팀은 글로벌 주요 IDM #사 기준 점유율 85%(2024년 기준)를 기록했으며, LPM은 11개사, 110개 모델 대응(커버리지 90% 이상)이 가능함. 이는 단순 기술 우위를 넘어 다양한 장비 모델이 적용되어 검증을 마친 경험이 누적되어 있음을 의미함. 고객사 입장에서는 신규 고객사를 테스트하는 과정에서 **장비 홀드, 재검증, 양산 안정화 등의 시간, 비용 부담**이 발생. 반면, 이미 표준화된 공급사를 선택하면 다운타임 리스크를 최소화할 수 있고 의사 결정 속도 또한 빨라짐. 3Q25 누적기준 상위 고객사 비중이 79%(B사 47%, C사 21%, A사 11%)라는 점은 IDM 중심으로 레퍼런스 기반 사업 구조가 이미 견고하게 자리잡았음을 의미

3. 경쟁이 제한적인 이유: 기술보다는 'DB, 현장 경험'이 진입 장벽

동사가 위치한 시장은 단일 부품 경쟁보다는, **고객 장비 라인업에 맞춰 개조, 셋업, 운영 최적화를 수행할 수 있는 경험과 데이터베이스(DB)가 핵심 경쟁력**. 저스팀은 약 110종 이상의 맞춤형 LPM을 개발, 납품해왔으며, JFS 역시 해외 IDM 양산 적용을 시작함. 경쟁사가 동일 형태의 제품을 제조할 수는 있지만, 모델 호환성 범위나 현장 셋업 경험, 양산 안정화 레퍼런스가 부족하다면 실질적인 대체 옵션이 되기 쉽지 않음. 실제로 2026년 1월 삼성전자향으로 추가 수주가 발생한 사례처럼, 검증된 공급사로 물량이 집중된 구조를 확인 가능

4. 저가 소모품 아니냐: 가격보다는 ROI 중심 시장

저스팀 제품은 단가 자체로 평가되는 소모품 성격의 아이템으로 보기 어려움. 환경 제어 장치는 가격보다 수율 개선과 가동률 안정화에 따른 경제성(ROI)이 의사 결정의 핵심 변수로 작용함. 특히 선단공정과 HBM처럼 수율 민감도가 높은 영역에서는 검증된 솔루션에 대한 선호가 더욱 강하게 나타남. JFS는 FOUP 내부를 저습 환경으로 안정적으로 유지함으로써, 수율 개선을 지원하는 방향으로 포지셔닝되어 있음

그림 6. 글로벌 주요 IDM 3사향 저스팀 공급 FAB 현황



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

5. 도입 난이도와 효과: 빠르게 붙고, 빠르게 확산되는 구조

팹 고객은 도입 난이도와 검증 기간에 매우 민감함. 저시스템은 LPM/BIP/CFB/JFS 제품군을 세분화하여 공정 및 장비 타입별 맞춤 대응이 가능하며, 특히 JFS는 EFEM 내부 기류 문제를 해결하는 구조로 FOUP 단위 제어를 넘어선 솔루션으로 진화함. 이는 기존 시스템 위에 추가 적용이 가능한 방식으로 확산 속도가 빠르다는 장점이 있음. 2026년 세미콘 코리아에서 2세대 JFS와 3세대 기능을 결합한 JDS가 공개되었으며, FOUP 1% 이내, EFEM 5~10% 이내 저습 유지 목표가 제시됨. 이러한 **고도화 제품의 등장은 ‘도입→운영 안정화→추가 발주’로 이어지는 선순환 구조**가 보다 명확해지고 있음을 보여줌

6. 왜 고객이 내재화하지 않는가: ‘만드는 것’보다 ‘운영하는 것’이 더 어렵다

동사 제품의 단가는 포트당 1,000~1,500만원 수준으로 장비 1대에 보통 3~4개 로드포트가 적용된다고 가정하면, EFEM 1대당 수천만원 내외의 투자로 환경 제어 시스템을 구축할 수 있음. 반면, 이를 자체 개발, 검증하려면 장비 모델별 설계 변경, 질소 배관 구성, 컨트롤 시스템 개발, 그리고 수개월 이상의 양산 검증이 필요함. 특히, 양산 라인에서 발생하는 다운타임 비용은 분기 수 백억원 단위의 손익에 영향을 미칠 수 있어, 검증되지 않은 내부 솔루션 적용은 현실적으로 부담이 큼. 고객 입장에서는 수천만원 단위 capex 투자로 수율 안정성과 가동률 개선이 기대된다면, 검증된 외부 공급사를 선택하는 것이 의사 결정 측면에서 합리적. 3Q25 누계기준 상위 3개사 매출비중이 79%에 해당하는 점은 대형 IDM사가 반복적으로 동사 제품을 채택하고 있으며, 단발성 납품 보다는 **일정 기간 성능과 경제성이 검증되었기 때문에 가능한 구조**. 외주가 더 싸고 빠르고 안전하기 때문에 동사 제품에 의존

7. 세대 전환 구조: 대체가 아닌 ‘Add-up’ 가능성

2세대, 3세대 제품은 1세대를 완전히 대체하기 보다는 제어 영역을 확장하며 매출이 추가되는 (Add-up) 구조에 가까움. 실제로도 기존 FOUP 단계어 위에 EFEM 제어, 나아가 온도/습도 통합 제어가 더해지는 구조로 1세대, 2세대 제품이 상호보완적으로 공급되며, 전체 솔루션 매출이 동반 확대되는 것을 확인할 수 있음. 단순 교체 수요가 아닌 설치 지점 확대에 따른 구조적 매출 증가로 이어질 수 있음

8. 발전 방향: EFEM Total Solution으로의 확장

동사의 장기 방향성은 환경 제어 모듈 공급을 넘어 EFEM 구간 전체를 아우르는 Total Solution 사업자로의 확장. 단순히 제품군을 추가하는 수준을 넘어 고객 공정의 병목 구간을 포괄적으로 개선하는 전략. 또한, HBM용 Hybrid Bonder 개발(135억원 규모의 국책과제)을 병행함으로써 환경 제어 기술을 기반으로 첨단 패키징 장비 시장까지 확장할 수 있는 옵션을 보유함. 이는 단기 실적 개선을 넘어 중장기 성장 스토리를 뒷받침하는 요소로 판단됨

그림 7. 저시스템의 저습도 관리 솔루션

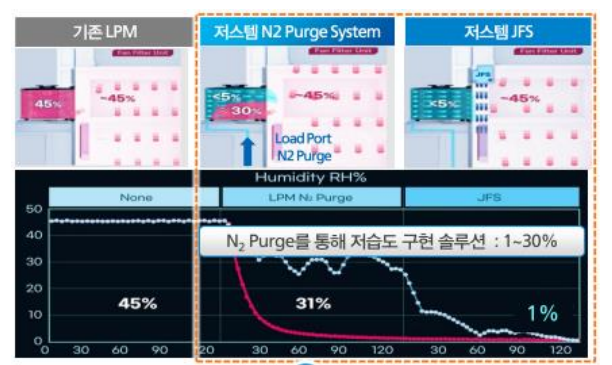


그림 8. 저시스템 주요 고객사



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

360대 수주로 확인된
확산 국면, 2026년 실
적 레버리지 본격화

투자포인트 1) 2 세대 JFS 증설 본격화: 구조적 확장 구간 진입

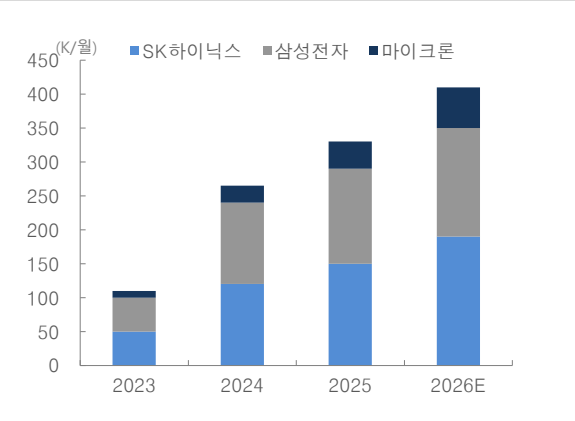
2026년은 2세대 JFS 공급 확대가 실적으로 본격 반영되는 첫해. 2025년 12월 50대 파일럿 공급 이후 2026년 1월 310대 추가 수주가 이어지며, 총 360대 규모로 확산된 점은, **파일럿 검증을 거쳐 양산 라인 확산 단계로 진입했음**을 보여줌. 단순 신규 납품이 아닌, 표준 채택 과정으로 해석 가능함. 리드타임은 약 6주 수준으로, 수주 발생 시 단기간 내 매출인식이 가능해 2026년 상반기 실적 가시성도 매우 높음. JFS는 기존 고객사 내 라인 단위 확산이 이뤄질 경우 **반복 수주 성격을 띠는 만큼, 안정적 매출 흐름을 형성 가능함. 또한, 장비 산업 특성상 고정비 레버리지 효과로** 외형성장과 동시에 수익성 개선이 동시에 나타나는 구간에 위치함

JFS가 적용되는 EFEM 구간은 신규 펌이든, 기존 라인의 공정 전환이든 반드시 거쳐야하는 인터페이스 영역. 웨이퍼가 노광, 식각, 증착 등 주요 공정을 오가기 전 대기하는 구간이 EFEM이며, 이 단계에서의 환경 관리가 전 공정의 수율 안정성과 직결됨. 따라서 라인 신설 뿐 아니라, 선단 공정으로의 업그레이드나 HBM 등 고사양 제품군 전환시에도 적용 논의가 동시에 진행됨. 또한, 첨단 공정은 **초기 램프업 구간에서 수율 안정화가 핵심 과제**이기 때문에, 환경 제어 솔루션은 후행적 보완 장치가 아니라 설계 단계에서부터 검토되는 항목. 즉, 특정 고객, 특정 프로젝트에 국한된 수요라기보다 Fab 단위 확산 가능성이 열려있음. EFEM 환경 제어는 **‘선택적 옵션’이 아니라, ‘공정 안정성 확보 장치’로 인식 범위가 확대**되고 있으며, 이는 라인 증설, 전환이 이어지는 구간에서 구조적으로 연결될 가능성이 높음

고객사별 투자 방향
및 반도체 CAPA 확대
흐름

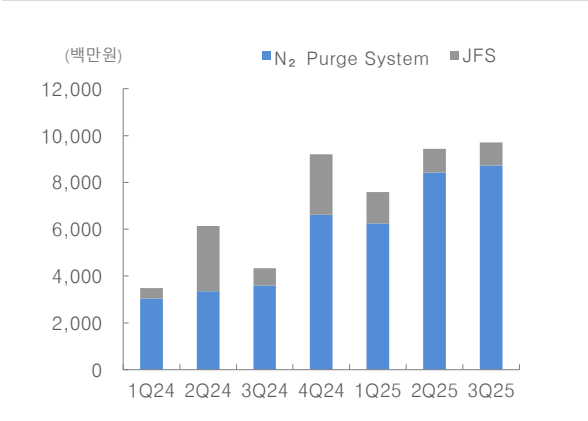
주요 메모리 업체들의 HBM 중심 증설 전략은 **EFEM 환경 제어 수요 확대의 직접적 배경으로 작용**하고 있음. 삼성전자는 2026년 HBM 매출을 전년 대비 대폭 확대하며, HBM3E 공급 확대와 HBM4 양산을 본격화할 계획을 밝힌 바 있으며, 이는 라인 전환과 신규 CAPA 증설을 동시에 진행하고 있음을 의미함. SK하이닉스 역시 2026년 HBM3E 중심의 출하 비중을 크게 높이며, HBM 시장 주도권을 유지할 전망이고, 마이크론 또한 선단 공정 및 메모리 중심의 투자기조를 이어가고 있음. 글로벌 메모리 업계 전반에서 **AI 서버향 고사양 메모리 생산 능력을 확대하는 구조적 사이클로**, HBM 라인 증설과 선단 공정 전환이 동시에 진행되는 환경에서는 EFEM 단계의 습도, 오염 제어 수요 역시 Fab 단위로 확대될 가능성

그림 9. 글로벌 IDM 3사 HBM CAPA 추이 및 전망



자료: Trend Force, 대신증권 Research Center

그림 10. 습도제어 솔루션(1, 2 세대) 매출 추이



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

투자포인트 2) 디스플레이, 플라스마 사업으로의 포트폴리오 확장

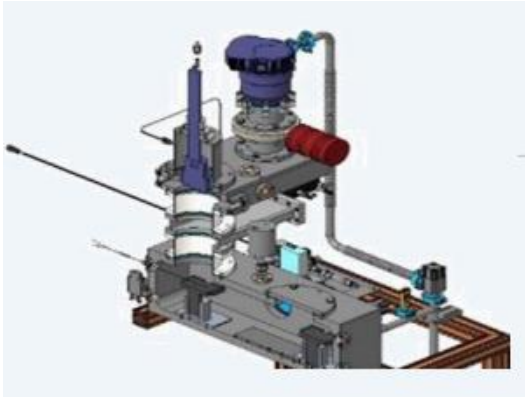
OLED 고진공 제전장치: 중화권 8.6G 투자 가시화 국면에서 '수율 관리 장치'로 채택 범위 확대

OLED 공정은 대면적 기판 이송 과정에서 정전기(ESD)로 인한 **파티클 부착/결함 증가**가 발생하기 쉬워 특히 고진공 조건에서의 안정적 제전은 수율과 직결. 저시스템은 고진공 이온나이저 시스템(VIS/VEES)을 전면내 내세와 고객사 확대를 추진 중이며, **국내 패널사 대형 OLED 라인 전면 적용 완료**, 다른 국내 패널사는 평가 마무리 단계(후속 라인 황전개 기대). 중화권의 경우도 **현장 평가 및 Demo 장비 수주 완료→연내 양산 수주 예정**이며, 추가적으로 2~3개 업체와도 구체적 논의 단계. 현재 IT OLED 시장 확대를 겨냥한 **8.6G OLED** 투자가 중국에서 이뤄지고 있으며, BOE는 청두 8.6G 라인에 총 630억원 위안(약 12조원) 규모 투자를 공표, Visionox도 550억 위안(약 11조원) 투자를 발표함. 이런 대형라인 투자는 초기 발주 및 평가 사이클이 비교적 길지만, 한 번 양산 레퍼런스를 확보하면 동일 고객사의 전 라인 확산으로 이어질 가능성이 높아 저시스템의 중장기 수주 확대에 이어질 가능성을 시사

자회사 플람(plam): 대기압, 저온 플라스마 기반 '표면 개질/세정'의 중장기 확장 가치

자회사 플람은 대기압, 저온 플라스마 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 태양광 공정에 적용 가능한 표면 개질 및 세정 장비를 개발, 공급하고 있음. 플람은 2016년 설립 이후 대기압 플라스마 기술을 상용화, 2019년에는 USC 양산 라인에 플라스마 제품을 적용하며 산업용 저온 플라스마의 양산화를 실현함. 또한 Cold Plasma, Multi Jet Plasma 기술은 태양광 세정 장비에 이미 적용되었으며, OLED 공정에서도 도입이 진행되고 있어 실제 산업 현장에서의 적용범위가 확대되고 있음. 현재 사업부의 매출 규모는 제한적이나, 반도체 환경 제어 기술에서 축적한 공정 이해도가 플라스마 응용 분야로 확장되는 구조라는 점에서 전략적 의미를 가짐

그림 11. 저시스템 대면적 OLED 제조용 고진공 장비



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

그림 12. 저시스템 플라스마 장비



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

2025년 턴어라운드 확인, 2026년 증설 사이클 수혜 본격화

2025년, 수주 확대와 함께 구조적 턴어라운드 구간 진입

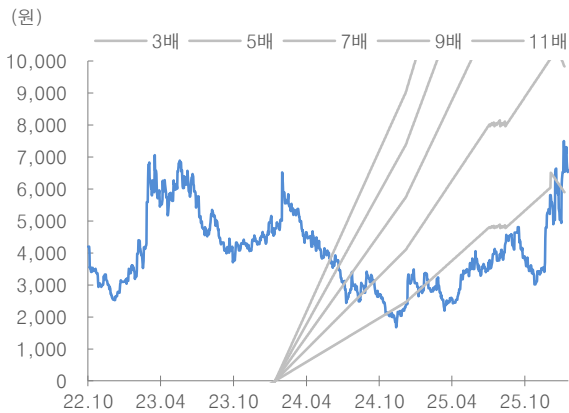
2025년 매출액은 499억원(YoY +29.0%), 영업이익은 58억원(흑자전환)으로 업황 부진 국면을 통과하며 실적 정상화와 기반을 마련한 해. 상반기부터 JFS 공급이 재개되며 매출 회복 흐름을 보였으며, 하반기에는 수주 증가와 실적 가시성이 점진적으로 개선됨. 특히 4분기부터는 2세대 JFS가 본격적으로 반영되기 시작하며 매출 구조가 개선되는 흐름 보임

2026년, 2세대 JFS 물량 본격 증가와 ASP 상승에 따른 이익 레버리지 확대

2026년은 매출액 807억원(YoY +61.6%), 영업이익 197억원(YoY +239.2%) 예상됨. 매출 증가는 1) HBM 및 선단공정 증설에 따른 2세대 JFS 물량의 본격 증가, 2) 3세대 고사양 제품의 초기 수주 가시화에 따른 ASP 상승 효과에 기인함. 특히 EFEM 단위 환경 제어 수요 확대는 신규 팹 증설뿐 아니라, 기존 라인의 고도화 전환 과정에서도 동반 적용되는 구조라는 점에서 수요의 지속성이 높음

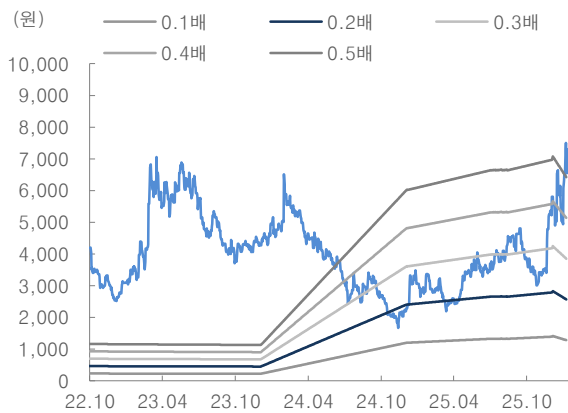
2026년은 고정비 부담을 상쇄하는 매출 규모에 도달하며 영업 레버리지가 크게 확대되는 구간으로 판단됨. 장비 산업 특성상 일정 매출 수준을 상회할 경우 이익으로 빠르게 전환되는 구조로, 고ASP 제품 믹스 확대는 수익성 개선 속도를 더욱 높일 수 있음. AI 서버 투자 확대와 HBM 증설 사이클이 이어지는 가운데, 동사는 EFEM 환경 제어라는 필수 공정 영역에서 직접적인 CAPA 증설 수혜를 받는 업체라는 점에서 중소형 반도체 장비 평균 대비 밸류에이션 프리미엄을 정당화할 수 있는 구간에 진입할 가능성이 높음

그림 13. 저스팀 PER 차트



자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 14. 저스팀 PBR 차트



자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 15. 저시스템의 기술 로드맵



자료: 회사자료, 대신증권 Research Center

표2. 주요 용어 정리

용어	정의
FOUP	Front Opening Unified Pod. 300mm 웨이퍼를 보관, 이송하는 밀폐형 용기. 내부 습도, 오염이 수율에 직접적 영향을 미치기 때문에 질소 퍼지 및 환경 제어가 중요
EFEM	Equipment Front End Module. 반도체 공정 장비의 전면부에서 웨이퍼 반입, 반출, 대기 기능을 담당하는 모듈. FOUP이 장착되는 구간이며 공정 외부 환경과 접하는 1차 오염 노출 구간
AMC	Airborne Molecular Contamination. 공기 중 존재하는 유기물, 산성가스 등 분자단위 오염물질. 미세선폭 공정에서 금속 부식, 패턴 손상, 수율 저하를 유발
N ₂ Purge	질소(Nitrogen) 가스를 주입해 FOUP 내부의 산소, 수분, 오염가스를 치환하는 기술. 습도를 낮추고 파티클 발생을 억제하여 웨이퍼 산화, 부식을 방지
LPM	Load Port Module. FOUP 장비와 연결하는 인터페이스 모듈. 각 공정 장비 앞에 설치되어 있으며 웨이퍼 로딩/언로딩 수행과 함께 내부 환경 제어 기능을 포함
BIP	Built in Purge. 반도체 제조 공정에서 사용되는 장치로, EFEM 내부에 설치되는 Batch형 타입. FOUP이 위치하여 웨이퍼를 원활히 공급 및 동일 조건을 유지할 수 있도록 하는 장비
습도 저감 Mode	버퍼 내부에 N ₂ 를 집중 분사하여 습도를 낮추는 기능
Fume 배출 Mode	버퍼 내부에 N ₂ 분사와 함께 배기(Exhaust)를 동시에 진행하여 불순물을 버퍼 외부로 배출하는 기능
CFB	Cluster Flow Box. Etch, 증착 등 공정 이후 잔류 가스나 오염물질을 제거하기 위한 흐름 제어 장치
JFS	Jet Flow Straightener. EFEM 내부 기류를 직진, 총류화해 균일한 질소 흐름을 형성하는 2세대 환경제어 솔루션. 기존 FOUP 내부 제어에서 EFEM 전체 환경 제어로 확장한 제품

자료: 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서	(단위: 억원)				
	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	0	0	461	359	387
매출원가	0	0	268	205	250
매출총이익	0	0	193	155	137
판매비와관리비	0	0	122	152	184
영업이익	0	0	71	3	-46
영업이익률	na	na	15.5	0.9	-11.9
EBITDA	0	0	78	14	-28
영업외손익	0	0	2	-51	14
관계기업손익	0	0	0	0	0
금융수익	0	0	12	24	47
외환관련이익	0	0	0	0	0
금융비용	0	0	-10	-48	-27
외환관련손실	0	0	5	2	2
기타	0	0	0	-27	-5
법인세비용차감전순손익	0	0	74	-48	-32
법인세비용	0	0	-10	14	10
계속사업순손익	0	0	63	-34	-22
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	0	0	63	-34	-22
당기순이익률	na	na	13.7	-9.4	-5.6
비지배지분순이익	0	0	0	0	0
지배지분순이익	0	0	63	-34	-21
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	0	0	0	0	0
포괄순이익	0	0	66	-36	-24
비지배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	0	0	66	-36	-24

Valuation 지표	(단위: 원, 배, %)				
	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
EPS	0	0	1,171	-486	-302
PER	#DIV/0!	#DIV/0!	6.4	NA	NA
BPS	0	0	3,130	2,307	2,255
PBR	0.0	0.0	2.1	2.8	2.9
EBITDAPS	0	0	483	68	-131
EV/EBITDA	0.0	0.0	15.7	115.3	NA
SPS	0	0	2,840	1,705	1,809
PSR	0.0	0.0	2.3	3.9	3.6
CFPS	0	0	636	183	56
DPS	0	0	0	0	0

재무비율	(단위: 원, 배, %)				
	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
성장성					
매출액 증가율	na	na	na	-22.1	7.7
영업이익 증가율	na	na	na	-95.6	적전
순이익 증가율	na	na	na	적전	적지
수익성					
ROIC	0.0	0.0	48.0	0.5	-5.7
ROA	0.0	0.0	20.3	0.4	-5.7
ROE	0.0	0.0	24.9	-6.8	-4.4
안정성					
부채비율	0.0	0.0	38.7	69.8	65.0
순차입금비율	0.0	0.0	-49.5	34.0	24.7
이자보상배율	0.0	0.0	28.7	0.3	-4.2

자료: 저스템, 대신증권 Research Center

재무상태표	(단위: 억원)				
	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
유동자산	0	0	463	277	248
현금및현금성자산	0	0	292	28	46
매출채권 및 기타채권	0	0	62	97	85
재고자산	0	0	45	37	28
기타유동자산	0	0	64	115	89
비유동자산	0	0	242	549	548
유형자산	0	0	200	434	444
관계기업투자금	0	0	0	0	0
기타비유동자산	0	0	42	115	104
자산총계	0	0	705	826	795
유동부채	0	0	127	99	296
매입채무 및 기타채무	0	0	69	57	45
차입금	0	0	15	20	20
유동성채무	0	0	18	12	30
기타유동부채	0	0	26	10	201
비유동부채	0	0	70	240	17
차입금	0	0	66	46	12
전환증권	0	0	0	126	0
기타비유동부채	0	0	3	69	5
부채총계	0	0	197	339	313
자배지분	0	0	508	486	482
자본금	0	0	35	36	36
자본잉여금	0	0	192	206	216
이익잉여금	0	0	272	236	212
기타지분변동	0	0	9	9	18
비자배지분	0	0	0	0	0
자본총계	0	0	508	486	482
순차입금	0	0	-251	165	119

현금흐름표	(단위: 억원)				
	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
영업활동 현금흐름	0	0	83	-82	43
당기순이익	0	0	63	-34	-22
비현금항목의 가감	0	0	40	72	33
감가상각비	0	0	7	11	18
외환손익	0	0	4	1	-3
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	0	0	29	61	18
자산부채의 증감	0	0	-1	-109	28
기타현금흐름	0	0	-19	-11	4
투자활동 현금흐름	0	0	-40	-292	-14
투자자산	0	0	61	-46	27
유형자산	0	0	-52	-239	-29
기타	0	0	-49	-8	-12
재무활동 현금흐름	0	0	184	111	-13
단기차입금	0	0	0	5	-5
사채	0	0	0	150	0
장기차입금	0	0	0	-10	0
유상증자	0	0	232	9	7
현금배당	0	0	0	0	0
기타	0	0	-49	-43	-15
현금의 증감	0	0	224	-263	17
기초 현금	0	0	0	292	26
기말 현금	0	0	224	28	43
NOPLAT	0	0	61	2	-31
FCF	0	0	14	-230	-50

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:김아영)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

[투자의견 및 목표주가 변경 내용]

저스텍(417840) 투자의견 및 목표주가 변경 내용

제시일자	26.02.21
투자의견	N/R
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	

제시일자	00.06.29
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항(기준일자:20260217)

구분	Buy(매수)	Marketperform(중)	Underperform(매도)
비율	89.5%	10.5%	0.0%

산업 투자의견

- Overweigh(비중확대)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상
- Neutral(중립)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상
- Underweigh(비중축소)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상

기업 투자의견

- Buy(매수)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 상승 예상
- Marketperform(시장수익률)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%p~10%p 주가 변동 예상
- Underperform(시장수익률 하회)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 하락 예상